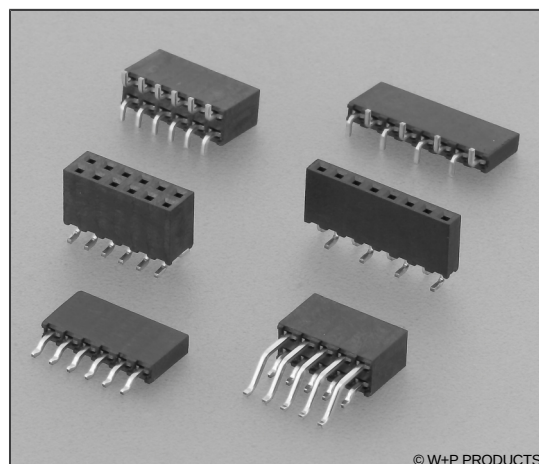


SMT-Buchsenleisten RM 2,00mm, stehend/liegend, 1-/2-reihig – BH 7,62mm SMT Female Headers, 2.00mm Pitch, Vertical/Horizontal, 1/2 Rows – 7.62mm Profile

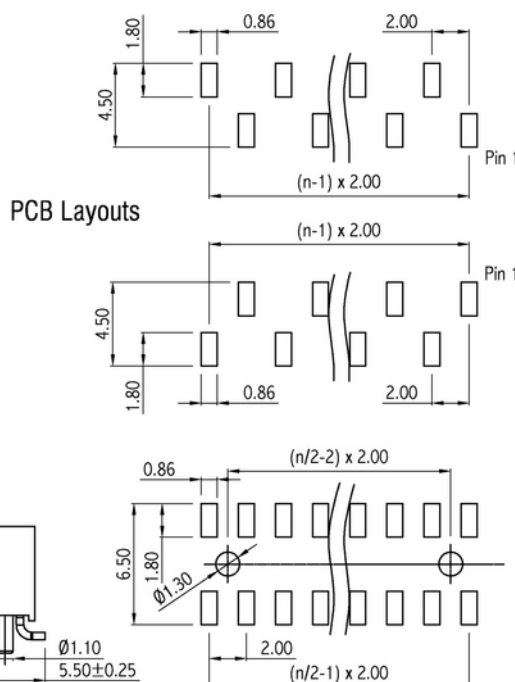
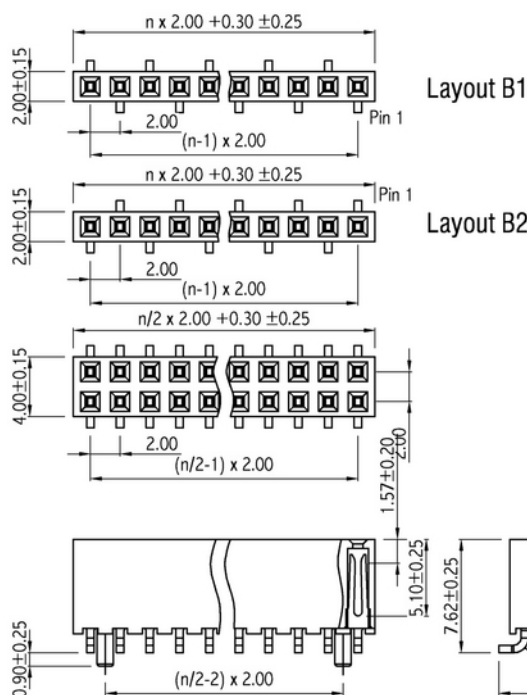
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
Contact Material	Phosphor bronze
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	500V _{AC}
Test Voltage	500V _{AC}
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	-40°C ... +105°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS

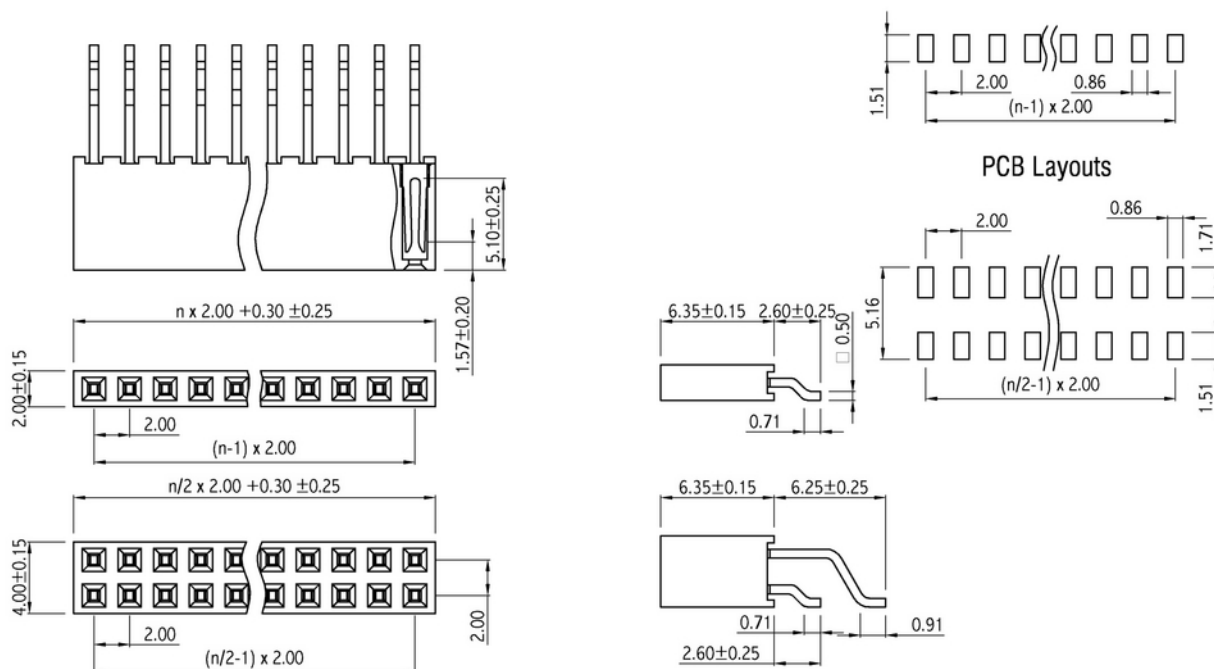
Gabelkontakte für Vierkantstifte 0,50mm.
Fork contacts accept 0.50mm square pins.



Series	Contacts*	Rows*	Type	Layout*	Plating*	Packaging*
4160	10	2	1	0	50	ST
	02-30 Einreihig Single row	1 Einreihig Single row	1 Stehend Vertical	1 Layout B1	00 Vergoldet Gold plated	ST
	04-60 Zweireihig Double row	2 Zweireihig Double row		2 Layout B2	50 Verzinnt Tin plated	PPST
				0 (zweireihig) (double row)	60 Sel. Au/Sn Duplex plating	PPTR

4160

SMT-Buchsenleisten RM 2,00mm, stehend/liegend, 1-/2-reihig – BH 7,62mm
SMT Female Headers, 2.00mm Pitch, Vertical/Horizontal, 1/2 Rows – 7.62mm Profile



Series	Contacts*	Rows*	Type	Plating*	Packaging*
4160	10	2	2	50	ST
	02-30 Einreihig Single row 04-60 Zweireihig Double row	1 Einreihig Single Row 2 Zweireihig Double row	2 Liegend Horizontal	00 Vergoldet Gold plated 50 Verzinkt Tin plated 60 Sel. Au/Sn Duplex plating	ST TR

Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads

PPST In Stangen mit P&P-Pads / In tubes with P&P-Pads

PPTR Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads

ST In Stangen / In tubes

TR Tape & Reel / Tape & Reel

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.

* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
FAX +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL sales@wppro.com
WEBSITE www.wppro.com

Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

